

四半期報告書

(第63期第1四半期)

自 平成26年4月1日
至 平成26年6月30日

株式会社フジインコーポレーテッド

愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目1番地1

目 次

頁

表 紙

第一部 企業情報	1
第1 企業の概況	1
1 主要な経営指標等の推移	1
2 事業の内容	1
第2 事業の状況	2
1 事業等のリスク	2
2 経営上の重要な契約等	2
3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析	2
第3 提出会社の状況	7
1 株式等の状況	7
(1) 株式の総数等	7
(2) 新株予約権等の状況	7
(3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等	7
(4) ライツプランの内容	7
(5) 発行済株式総数、資本金等の推移	7
(6) 大株主の状況	7
(7) 議決権の状況	8
2 役員の状況	8
第4 経理の状況	9
1 四半期連結財務諸表	10
(1) 四半期連結貸借対照表	10
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	12
2 その他	16
第二部 提出会社の保証会社等の情報	17

[四半期レビュー報告書]

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年8月8日
【四半期会計期間】	第63期第1四半期（自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日）
【会社名】	株式会社フジミインコーポレーテッド
【英訳名】	FUJIMI INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 関 敬史
【本店の所在の場所】	愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目1番地1
【電話番号】	052-503-8181（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 鈴木 彰
【最寄りの連絡場所】	愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目1番地1
【電話番号】	052-503-8181（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 鈴木 彰
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号）

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次	第62期 第1四半期 連結累計期間	第63期 第1四半期 連結累計期間	第62期
会計期間	自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日	自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日	自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日
売上高 (百万円)	6,973	7,543	27,492
経常利益 (百万円)	496	877	1,535
四半期（当期）純利益 (百万円)	348	720	799
四半期包括利益又は包括利益 (百万円)	709	675	1,482
純資産額 (百万円)	41,219	41,814	41,507
総資産額 (百万円)	46,802	47,108	46,648
1株当たり四半期（当期） 純利益金額 (円)	13.43	27.76	30.82
潜在株式調整後1株当たり 四半期（当期）純利益金額 (円)	—	—	—
自己資本比率 (%)	87.96	88.76	88.87

- (注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 売上高には消費税等は含まれておりません。
3. 潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- なお、第63期第1四半期連結会計期間の末日においては、潜在株式は存在しておりません。

2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び子会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第1四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く環境は、米国、欧州、日本など主要先進国で景気回復基調が続きましたが、中国をはじめとするアジア新興国においては、依然として先行きに不透明感が残る状況でありました。

世界半導体市場は、スマートフォンやタブレット端末関連需要の拡大により概ね堅調に推移しました。このため、主力のシリコンウェハー市場につきましてもウェハー出荷が高い水準で推移するなど、回復局面となりました。

こうした状況下、当社グループでは一丸となって売上拡大とコスト削減に努めた結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高7,543百万円（前年同期比8.2%増）、営業利益857百万円（前年同期比122.4%増）、経常利益877百万円（前年同期比76.8%増）、四半期純利益720百万円（前年同期比106.8%増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

日本につきましては、堅調な半導体市場を背景にシリコンウェハー向け製品の販売が増加したものの、CMP向け製品の一部売上が北米セグメントに移管されたことによる販売減少により、売上高は4,115百万円（前年同期比0.3%減）、製品構成の良化によりセグメント利益（営業利益）は821百万円（前年同期比8.8%増）となりました。

北米につきましては、CMP向け一部製品が日本セグメントより移管されたこともあり売上高は1,116百万円（前年同期比4.4%増）、グループ内の知的財産管理の再編の影響によりセグメント利益（営業利益）は79百万円（前年同期比379.2%増）となりました。

アジアにつきましては、最先端ロジックデバイス向けCMP製品およびアルミディスク向け製品の販売が増加したことから、売上高は1,946百万円（前年同期比46.5%増）、セグメント利益（営業利益）は286百万円（前年同期はセグメント損失79百万円）となりました。

欧州につきましては、シリコンウェハー向け製品やCMP向け製品の販売が減少したことから売上高は364百万円（前年同期比18.5%減）となりましたが、為替の影響などによりセグメント利益（営業利益）は28百万円（前年同期比11.3%増）となりました。

主な用途別売上の実績は、次のとおりであります。

シリコンウェハー向け製品につきましては、半導体市場の需要増加の影響を受け、ラッピング材の売上高は772百万円（前年同期比0.8%増）、ポリシング材の売上高は1,464百万円（前年同期比7.1%増）となりました。

CMP向け製品につきましては、アジア市場で先端ロジックデバイス向け製品の販売が好調であったことから、売上高は2,368百万円（前年同期比9.1%増）となりました。

ハードディスク向け製品につきましては、アルミディスク向け製品の販売が好調であったことから売上高は761百万円（前年同期比27.9%増）となりました。

非半導体関連の一般工業用研磨材につきましては、売上高は1,601百万円（前年同期比1.7%増）となりました。

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については以下のとおりであります。

１．基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。

当社の株式は金融商品取引所に上場されていることから、資本市場において自由に取引されるべきものであると考えております。したがって、当社の株券等の大規模買付行為（下記３．②に定義します。以下同じとします。）については、原則としてこれを否定するものではなく、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づいて決定されるべきものと考えております。また、当社は、当社の株券等の大規模買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株券等の大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、十分な時間や情報が提供されないまま、株主に株式の売却を事実上強要する恐れのあるものや、対象会社の取締役会や株主が当該大規模買付行為の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案の提案等を行うための十分な時間や情報を与えないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社の企業価値の源泉を十分に理解し、これらの中長期的に確保し、長年築きあげてきた技術、ノウハウなどの無形の経営資源と市場とを有機的に結合させ企業価値の増大を図る経営をすることができなければ、ステークホルダーの信頼を得ることができず、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反することとなると考えます。

当社は、上記のような当社の企業価値の源泉を理解せず、これらの中長期的に確保し、企業価値の増大を図る経営を企図しない大規模買付行為やこれに類似する行為により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する恐れがある当社の株券等の大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

２．基本方針の実現に資する取組みの概要

① 当社の企業価値の源泉について

当社の創業以来蓄積されたノウハウと研究開発力から生まれた当社製品の数々は、シリコンウェハーに代表される半導体基板の鏡面研磨、半導体チップの多層配線に必要なCMP（化学的機械的平坦化）、ハードディスクの研磨など高精度な表面加工が求められる先端産業に欠かせぬものとなっております。なかでも、主力事業分野である半導体基板向け超精密研磨材では世界ナンバーワンのマーケットシェアを維持しており、超精密研磨のリーディングカンパニーとして、大手企業の新規参入に対して市場優位性を維持しております。

最近では、LED、ディスプレイ、パワーエレクトロニクス用部品等の硬脆材の表面加工分野やその他様々な表面加工のニーズに独自のソリューションで応える取組みを積極的に進めております。また、溶射技術や装置に最適な溶射材の開発・商品化で新分野を開拓しております。

このように当社は、「パウダー&サーフェイス分野」を事業領域として、コア技術を高め先端技術をリードすることにより、お客様の満足度を高め信頼を勝ち得てまいりました。また、当社が特定の企業グループに属することなく独立性の高い経営を堅持していることも、多くのお客様から受け入れていただいている一因と考えております。

当社のコーポレートスローガン「技術を磨き、心をつなぐ」には、先端技術を通してより良い製品づくりに貢献し、人々の心をつなぎ、生活を豊かにするという意味が込められており、人を尊重し地球環境に配慮した製品づくりが当社の「ものづくり」の根底に流れております。

当社はこうした「ものづくりの精神」と従業員一人ひとりが変化に果敢に挑戦するという企業風土とITを駆使した情報の共有化をテコに、企業競争力の向上と持続的成長によって企業価値を増大してまいりました。

当社の企業価値の源泉は、こうした製造現場と一体となった高い技術力・開発力、長い歴史のなかで培われたお客様との信頼関係、労使間の健全かつ一体感のある企業風土にあると考えております。

今後の技術革新をリードし業績の拡大を目指していくためにも、お客様の信頼度のさらなる向上、従業員の士気向上を図っていくことが重要と考えており、当社はこうした方針のもと、引き続き企業価値の向上にグループを挙げ取り組んでまいります。

② 企業価値向上のための取組み(中期経営計画)

当社は、バランス・スコアカード（ＢＳＣ）の考え方を基に、平成21年6月に平成30年3月（2018年）期を最終年度とする9年間の中長期経営計画を策定いたしました。

この中長期経営計画は3年を区切りとする3次の中期計画を基にしています。

第一段階は自己診断と成長のための基礎体力づくり、成長のための種まきにあて、第二段階はまいいた種をきちんと育てる時期、そして第三段階は事業が花開き、実を収穫する時期、と位置づけ、単に計画期間における売上や利益率の向上を目指すだけでなく、当社のあるべき姿、進むべき道をより明確にするため、企業理念・ビジョンの見直しを図り、実践してまいりました。

現在は第二段階にあたり、お客様のニーズを把握し、それを具現化し、より高い満足を提供する為、「お客様目線の実践」を経営方針に掲げ、展開してまいりました。その結果、お客様満足度と製品品質面において評価をいただいております。

当社はこれまで半導体市場を主たる事業領域としてまいりましたが、当社を取り巻く事業環境は大きく変化しております。当社が主に事業展開している半導体市場は、2008年のリーマンショックを発端とする世界同時不況により、携帯電話やデジタル家電など様々な商品の販売が失速し影響を受けました。その後、パソコンの出荷台数は減少したものの、スマートフォンやタブレット（多機能携帯端末）関連需要の拡大等により半導体市場規模は回復し、再び成長の兆しを見せております。しかしながら、当社が主力事業として研磨材を提供している半導体基板であるシリコンウェハについては、面積ベースでは半導体市場同様に回復後、現在は横ばい基調にあるものの、単価の下落により販売額の減少が続いております。その結果、当社がお客様に提供する研磨材についても価格競争や使用量の削減の動きが高まっております。

こうした事業環境下で安定的かつ持続的な成長を遂げるためには、当社は特定の市場や用途に偏ることがない事業構造が必要であると考えております。

そこで、当社は、企業ビジョンとして、「既存事業の強化を図りつつ新規分野に積極果敢にチャレンジし、半導体関連分野（シリコン・CMP）と非半導体関連分野の安定した事業バランスの構築を目指します」を掲げ、従来から推進しているシリコン・CMP・ディスク・機能材・溶射材の5事業に加え、平成26年4月の組織変更において「新規事業本部」を設置し、非半導体分野の新規事業の探索と育成のための推進体制を強化いたしました。

これらを通じて安定した事業構造を維持するため、将来的には事業構造比率として半導体関連比率50%、非半導体関連比率50%を目指しております。

また、全社レベルの目標を事業ごとに戦略目標、施策として具現化し、その成果については評価指標（KPI）によって定期的に進捗管理するなど、明確な責任体制のもと事業戦略を組織横断的に展開しております。

[シリコン事業]

半導体基板となるシリコンウェハを高精度に平坦化・鏡面研磨する研磨材事業です。

お客様と価値観を共有し、当社だからこそ提供できる切断からファイナル研磨までのウェハ加工プロセス全体にわたる総合サービスの提供を通し、お客様の「最も信頼できるパートナー」を目指してまいります。また、従来のシリコンウェハに加え、パワーデバイス基板向け製品開発の推進と、半導体周辺用途へのトータルソリューション提案を強化してまいります。

[CMP事業]

半導体デバイスの製造工程で用いられる研磨材事業です。半導体デバイスの高密度化・高集積化に伴い、CMPが適用される工程は増加傾向にあります。お客様が拠点を置く日本・アメリカ・台湾に開発・製造拠点を設けており、お客様とより密接な関係を構築し、お客様のロードマップに沿った新製品を迅速に開発することのみならず、安定で高品質な製品・サービスを提供できるよう努めてまいります。

[ディスク事業]

パソコンやHDD搭載型TV、DVD・BDレコーダーなどの記憶媒体であるハードディスク用の研磨材事業です。お客様の生産拠点が集中するマレーシアに製造拠点を置くとともに技術スタッフを配置し、お客様への技術サポートを強化することで信頼関係を構築し、次世代ディスク基板への要求を共有することにより、お客様の要求に合った新製品をタイムリーに提供してまいります。

[機能材事業]

電子部品、自動車、レンズ等の業界における精密砥石、研磨布紙及び一般ラッピング・ポリッシング関係を中心とした研磨材、機能性材の事業です。各種用途における開発力を強化し、お客様の潜在的なニーズまでも引き出し、的確な提案をすることにより、お客様の信頼を高めていくよう努めてまいります。また、研磨材の新たな用途もお客様との関係を強化していく中で探索してまいります。

[溶射材事業]

鉄鋼、航空機及び半導体等様々な業界における長寿命化、高機能化を実現するために、環境に優しい表面処理として使用される溶射用途向けに、主にサーメット、セラミックスなどの粉末溶射材を提供している事業です。開発力を強化し、新規高機能製品の早期市場投入やお客様へのタイムリーなソリューションの提案により、売上の拡大とともに、収率改善や生産技術力の向上により収益改善とさらなる品質の安定化を図ってまいります。

[新規事業]

シリコン、CMP、ディスクなど既存事業以外の新規用途で用いられる研磨材等を提供している事業です。基幹事業である半導体の後に続く、LED、ディスプレイ、携帯端末等の様々な事業機会に対応しております。世界の様々な業界のお客様から寄せられる、新たな表面加工ニーズに、トータルソリューションでお応えしてまいります。

3. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要

①当社株券等の大規模買付行為に関する対応策の目的

上記1. 記載の基本方針に基づいて、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するような一方的かつ大規模な買付行為及びその類似行為を行う者に対しては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するために、もっとも適切と思われる措置を迅速かつ的確に講じる必要があると認識しております。このような認識のもと、当社取締役会は、こうした不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するとともに、大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様へ代替案を提案したり、あるいは株主の皆様にかかる大規模買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主共同の利益のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的として、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下「本対応方針」といいます。）を更新することを決定いたしました。また、本対応方針の更新については、平成26年6月24日開催の定時株主総会でご承認をいただきました。

②当社株券等の大規模買付行為に関する対応策の概要

本対応方針は、（ア）当社が発行する株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得、もしくは、（イ）当社が発行する株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けのいずれかに該当する買付けその他の取得もしくはこれに類似する行為又はこれらの提案（「（2）事業上及び財務上の対処すべき課題」において、あわせて「大規模買付行為」といいます。）を適用対象としています。

本対応方針では、当社取締役会が、大規模買付行為を行い又は行おうとする者（以下「大規模買付者」といいます。）に対して本対応方針に定める大規模買付情報の提供を要請するための手続を定めています。

取締役会は、（ア）大規模買付者等が本対応方針に定められた手続を遵守せず、又は（イ）大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうような、本対応方針に定める一定の類型に該当すると判断される場合又は該当すると客観的かつ合理的に疑われる事情が存する場合には、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、所定の期間内に、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。

当社取締役会は、上記独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、本対応方針における対抗措置の発動を決定します。当社取締役会が対抗措置として一定の行使条件及び取得条項等が付された新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の無償割当ての実施を決議した場合、当社は、本新株予約権を当該決議によって定める全ての株主に対して無償割当ての方法により割り当てます。

4. 上記取組みが基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものでないこと及びその理由

上記2. 記載の取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針に沿うものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもない判断しております。

また上記3. 記載の取組みである本対応方針は、大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様へ代替案を提案したり、あるいは株主の皆様にかかる大規模買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主共同の利益のために交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させるための枠組みであり、基本方針に沿うものであると考えております。

さらに、本対応方針は、（ア）株主総会の承認により継続され、また必要があれば株主意思確認総会を経る場合があるなど、株主意思を重視するものであること、（イ）経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足し、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」に関する議論等をも踏まえていること、（ウ）合理的かつ客観的な対抗措置発動要件が設定されていること、（エ）当社取締役会から独立した組織として独立委員会が設置され、取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重して意思決定することとされていること、（オ）本対応方針は、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会で選任された取締役で構成された取締役会により、いつでも廃止することができるものとされていること、（カ）当社の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとされていること等から、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

（３）研究開発活動

当第1四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費は、718百万円であります。なお、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

（４）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループは一部主要原材料を輸入や外部メーカーに依存しており、特に新興国の需要増加や原産国の政策等により影響を受ける可能性があります。

また、当社製品は半導体業界への売上依存度が高く、パソコン・モバイル端末をはじめとする世界の情報通信機器の市場動向やデジタル家電製品の需要動向が、当社業績に影響を与える可能性があります。

当社グループとしては、どのような景気変動下にあっても安定的な成長を遂げるため、特定の事業や用途に偏ることがない事業構造への転換が必要と考え、従来から推進しているシリコン・CMP・ディスク・機能材・溶射材の5事業分野に加え、平成26年4月の組織変更において「新規事業本部」を設置し、新規事業と新たな用途の探索に継続的にチャレンジし、持続的成長を可能とする事業構造の実現に向け注力して参ります。

（５）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資金状況は、売上収入を主な財源としております。また、当第1四半期連結会計期間末の流動比率は618.9%であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。

（６）経営者の問題認識と今後の方針について

当第1四半期連結累計期間において、当社グループの経営陣の問題認識と今後の方針について重要な変更はありません。

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
普通株式	120,000,000
計	120,000,000

②【発行済株式】

種類	第1四半期会計期間末 現在発行数（株） （平成26年6月30日）	提出日現在発行数（株） （平成26年8月8日）	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	30,699,500	30,699,500	東京証券取引所 名古屋証券取引所 各市場第一部	単元株式数 100株
計	30,699,500	30,699,500	—	—

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
平成26年4月1日～ 平成26年6月30日	—	30,699,500	—	4,753	—	5,038

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26年6月30日現在

区分	株式数 (株)	議決権の数 (個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式 (自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式 (その他)	—	—	—
完全議決権株式 (自己株式等)	普通株式 4,760,600	—	—
完全議決権株式 (その他)	普通株式 25,913,800	259,138	—
単元未満株式	普通株式 25,100	—	—
発行済株式総数	30,699,500	—	—
総株主の議決権	—	259,138	—

(注) 「完全議決権株式 (その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式900株 (議決権の数9個) を含めております。

② 【自己株式等】

平成26年6月30日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数 (株)	他人名義所有 株式数 (株)	所有株式数の 合計 (株)	発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%)
株式会社フジインコー ポレーテッド	愛知県清須市西枇杷 島町地領二丁目1番 地1	4,760,600	—	4,760,600	15.52
計	—	4,760,600	—	4,760,600	15.52

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

第4【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間（平成26年4月1日から平成26年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成26年4月1日から平成26年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	12,709	12,847
受取手形及び売掛金	5,780	6,352
有価証券	5,106	5,106
商品及び製品	2,721	2,859
仕掛品	894	851
原材料及び貯蔵品	1,491	1,555
繰延税金資産	393	321
その他	825	864
貸倒引当金	△25	△27
流動資産合計	29,898	30,731
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	7,779	7,680
その他（純額）	6,791	6,591
有形固定資産合計	14,570	14,272
無形固定資産	593	558
投資その他の資産		
投資有価証券	126	148
繰延税金資産	176	126
その他	1,515	1,503
貸倒引当金	△232	△232
投資その他の資産合計	1,586	1,545
固定資産合計	16,750	16,377
資産合計	46,648	47,108

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年 3 月31日)	当第 1 四半期連結会計期間 (平成26年 6 月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,713	2,994
未払法人税等	56	64
繰延税金負債	—	0
賞与引当金	554	352
役員賞与引当金	—	19
その他	1,389	1,535
流動負債合計	4,713	4,965
固定負債		
繰延税金負債	13	15
退職給付に係る負債	389	290
その他	23	22
固定負債合計	427	328
負債合計	5,140	5,294
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,753	4,753
資本剰余金	5,069	5,069
利益剰余金	37,052	37,452
自己株式	△5,711	△5,711
株主資本合計	41,163	41,563
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	48	63
為替換算調整勘定	340	276
退職給付に係る調整累計額	△93	△89
その他の包括利益累計額合計	295	250
新株予約権	48	—
純資産合計	41,507	41,814
負債純資産合計	46,648	47,108

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
売上高	6,973	7,543
売上原価	4,599	4,632
売上総利益	2,374	2,910
販売費及び一般管理費	1,988	2,052
営業利益	385	857
営業外収益		
受取利息	20	10
為替差益	81	0
廃棄物処分益	6	11
その他	7	11
営業外収益合計	115	34
営業外費用		
固定資産除売却損	2	12
その他	2	2
営業外費用合計	4	14
経常利益	496	877
特別利益		
新株予約権戻入益	0	48
特別利益合計	0	48
税金等調整前四半期純利益	497	926
法人税、住民税及び事業税	32	132
法人税等調整額	116	73
法人税等合計	148	206
少数株主損益調整前四半期純利益	348	720
四半期純利益	348	720

【四半期連結包括利益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	348	720
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2	14
為替換算調整勘定	358	△64
退職給付に係る調整額	—	4
その他の包括利益合計	360	△44
四半期包括利益	709	675
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	709	675

【注記事項】

(会計方針の変更)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用しております。

退職給付会計基準等の適用に伴い、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を見直し、平均残存勤務期間に対応する単一の債券利回りを基礎として決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第1四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第1四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が107百万円減少し、利益剰余金が69百万円増加しております。また、当第1四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
減価償却費	475百万円	432百万円

(株主資本等関係)

I 前第1四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)

配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成25年6月21日 定時株主総会	普通株式	518	20	平成25年3月31日	平成25年6月24日	利益剰余金

II 当第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)

配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成26年6月24日 定時株主総会	普通株式	389	15	平成26年3月31日	平成26年6月25日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	日本	北米	アジア	欧州	合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
売上高							
外部顧客への売上高	4,128	1,068	1,328	447	6,973	—	6,973
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,328	308	29	—	1,666	△1,666	—
計	5,456	1,377	1,358	447	8,639	△1,666	6,973
セグメント利益又は 損失(△)	755	16	△79	26	718	△332	385

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額△332百万円は、セグメント間取引消去2百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△347百万円及び棚卸資産の調整額12百万円であります。全社費用の主なものは、当社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	日本	北米	アジア	欧州	合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
売上高							
外部顧客への売上高	4,115	1,116	1,946	364	7,543	—	7,543
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,400	214	34	—	1,649	△1,649	—
計	5,516	1,330	1,981	364	9,192	△1,649	7,543
セグメント利益	821	79	286	28	1,215	△357	857

(注) 1. セグメント利益の調整額△357百万円は、セグメント間取引消去0百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△355百万円及び棚卸資産の調整額△2百万円であります。全社費用の主なものは、当社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額	13円43銭	27円76銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額(百万円)	348	720
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る四半期純利益金額(百万円)	348	720
普通株式の期中平均株式数(株)	25,939,107	25,938,833
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	平成19年6月22日株主総会決議の新株予約権 (新株予約権の数 1,300個)	平成19年6月22日株主総会決議の新株予約権は、平成26年6月30日に権利行使期間満了により失効しました。

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、当第1四半期連結会計期間の末日においては、平成26年6月30日に新株予約権が権利行使期間満了により失効したため、潜在株式が存在しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

該当事項はありません。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成26年 8 月 6 日

株式会社フジミインコーポレーテッド

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊集院

邦光

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

城

卓男

印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フジミインコーポレーテッドの平成26年4月1日から平成27年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成26年4月1日から平成26年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成26年4月1日から平成26年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フジミインコーポレーテッド及び連結子会社の平成26年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記は四半期レビュー報告書に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
2. X B R L データは四半期レビューの対象には含まれていません。